

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2026-017

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于对外投资进展以及增加投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资事项基本概述

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶方科技”）专注于传感器领域先进封装技术服务，通过技术创新、积极融入全球产业链体系、开展先进技术国际并购整合等，发展为全球传感器领域晶圆级 TSV 封装技术的领先者，核心客户涵盖国际头部设计公司，在全球传感器细分产业链中占据一席之地。

近年来，全球政治格局形势剧变，国际间战略博弈日趋激烈。集成电路产业作为信息经济时代的战略性基础产业，尤其成为大国博弈竞争的战略焦点，全球产业链正在发生重构整合，呈现出区域性、本地化发展趋势。为有效应对产业重构趋势，稳固公司市场地位，拓展公司产业服务能力，公司 2022 年开始积极推进国际化发展战略，进行市场、供应链、生产制造能力的全球布局。

2024 年 6 月 27 日公司召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，决议通过新加坡子公司 OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD（以下简称“OPTIZ PIONEER”），在马来西亚 100%持股设立 WaferTek Solutions Sdn. Bhd.（以下简称“WaferTek”），由 WaferTek 作为公司海外业务拓展与生产制造主体，积极推进海外生产基地布局，项目拟投资金额为 5,000 万美元，主要用于土地、厂房的购买与建设，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 28 日披露的《晶方科技关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：临 2024-030）。

2024 年 10 月 29 日公司召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于对外投资进展以及增加投资额度的议案》，决议向 WaferTek 增加 3,000

万美元投资额度，用于推进无尘室、厂务系统以及水电气等基础设施的建设与完善，增加后公司对 WaferTek 的投资总额增加到 8,000 万美元，具体情况详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《晶方科技关于对外投资进展以及增加投资额度的公告》（公告编号：临 2024-044）。

二、对外投资进展情况

WaferTek 成立以来，积极筹划海外生产基地拓展布局，努力推进土地厂房购买洽谈、生产工艺与产线规划、供应链拓展、团队组建等相关工作。截至目前已完成土地、厂房的购买与资产交割；无尘室、厂务系统以及水电气等基础设施的建设与完善工作也已基本完成；生产工艺与设备选型、团队组建与培训工作正在有序展开，正在进入设备的购置、安装、调试等产线建设与验证阶段。

三、增加投资额度的情况

（一）增加投资额度基本情况

鉴于公司马来西亚项目已顺利完成土地厂房购置，无尘室、厂务系统以及水电气等基础设施建设也已基本完成，项目正在进入设备的选型、购买、安装调试及产线验证阶段。为有效推进项目的顺利开展，公司计划向 WaferTek 增加 3,000 万美元投资额度，用于设备的购置与产线建设，资金来源为公司自有资金。

（二）董事会审议情况

2026 年 5 月 26 日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于对外投资进展以及增加投资额度的议案》。

本次增加投资事项在公司董事会授权范围之内，无需提交公司股东会审议。本次增加投资额度不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次增加投资额度对上市公司的影响

本次投资旨在积极推进公司马来西亚生产制造基地的建设，提升公司生产制造与技术服务能力，更好贴近海外市场与客户需求，实现公司业务的持续性增长，以及国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局，从而有效应对全球

产业重构融合的新发展趋势。

五、本次投资的风险分析

马来西亚拥有良好的商业环境，槟城是马来西亚最重要的制造业中心之一，在电子、半导体、汽车零部件等领域具备良好的产业与人才基础。受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等诸多因素影响，本次投资预期的实现也相应存在不确定性的风险。公司将努力推进全球业务、生产制造能力建设、项目拓展等事项的动态布局，整合各项资源，做好相关风险的管理工作，切实有效地降低投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2026年5月27日